

Summary of semiconductor product companies in various subdivisions! – September 29, 2021

半导体各细分产品企业汇总!

关键字：[半导体](#)

手机看文章

**[导读]**一、IC设计公司1、国际：高通、博通、联发科、英伟达、美满、赛灵思、Altera2、中国台湾：主要有联发科、敦泰科技、义隆电子、神盾科技、凌阳、威盛等。3、中国大陆：紫光展锐、中兴微电子、敦泰、海思半导体、全志科技、华大半导体、大唐半导体、智芯微电子、国微技术、中星微电子、紫光国芯、国民技术、欧比特、中颖电子、澜起科技、北斗星通、北京君正、兆易创新、格科微电子、中国电子、韦尔半导体、同创国芯、复旦微电子、艾派克微电子、汇顶科技、联发科、集创北方、同方微电子、中天联科、圣邦微电子等。二、半导体材料公司1、国际：JSRMcroelectronics、ETSCTechnologiesCo.、SEMI...



### 一、IC设计公司

1、国际：高通、博通、联发科、英伟达、美满、赛灵思、Altera

- 2、中国台湾：主要有联发科、敦泰科技、义隆电子、神盾科技、凌阳、威盛等。
- 3、中国大陆：紫光展锐、中兴微电子、敦泰、海思半导体、全志科技、华大半导体、大唐半导体、智芯微电子、国微技术、中星微电子、紫光国芯、国民技术、欧比特、中颖电子、澜起科技、北斗星通、北京君正、兆易创新、格科微电子、中国电子、韦尔半导体、同创国芯、复旦微电子、艾派克微电子、汇顶科技、联发科、集创北方、同方微电子、中天联科、圣邦微电子等。

## 二、半导体材料公司

- 1、国际：JSR Microelectronics、ETSC Technologies Co.、SEMI、Air Products、Ablestik、Cadence、Abrasive Technology、Praxair Electronics、TBW Industries、Applied Materials
- 2、中国大陆：特普高实业，浙江金瑞泓、南京国盛、河北普兴、有研、山东科大鼎新、北京达博、宁波江丰、有研亿金、上海新阳、安集、中能硅业科技、中环半导体、晶龙集团、新特能源、西安隆基、中硅高科、阳光能源、奥瑞德光电、天宏硅业、上海申和热磁（日企独资）、国盛电子、江丰电子材料、有研亿金、北京达博、上海新阳、安集微电子、有研新材料、湖北兴福电子、江化微、金瑞泓等。

## 三、半导体设备制造企业

- 1、晶圆清洗设备：Applied Materials、Dainippon Screen（DNS）常州硅密，昆山智程、北京华林嘉业，苏州施密科，宁波润华全芯，天津南轩，山东杰盛等
- 2、热处理设备：Applied Materials、ASM
- 3、离子注入设备：Applied Materials
- 4、CVD / PECVD / ALD设备：
- 5、PVD设备：Applied Materials、Aviza Technology、KDF、Novellus、Oerlikon、北方微电子
- 6、光刻设备：ASML、Canon、EV Group、Molecular Imprints、Nikon Precision，北京京圳
- 7、涂布 / 显影设备：DNS、EV Group、Suss MicroTec、TEL、沈阳芯源 宁波润华全芯
- 8、刻蚀 / 去胶 / 灰化设备：Applied Materials、Aviza Technology、Axic、Hitachi High Technologies 宁波润华全芯 合肥真萍科技
- 9、CMP设备：Applied Materials、Ebara Corporation、Entrepix、Kinetic Systems、Novellus
- 10、电镀系统设备：Applied Materials、ECI Technology、Novellus、Semitool、Surfact
- 11、半导体工艺用石墨元件 / 材料：POCO Graphite、Carbone Lorraine、TOYO TANSO

12、封装测试设备：杭州长川，派利德科技，深圳诺泰，深圳复德，太仓晨启等；

13、水处理设备：深圳纯水一号，深圳水视界 常州威立雅等

中国大陆：北方华创微电子装备、中微半导体设备、上海微电子装备、拓荆科技、中电科电子装备集团、中微半导体，七星华创、华海清科、深南电路、睿励科学仪器、上海微电子、达谊恒精密机械、汉民科技、琦升机械设备、上海康克仕商贸等。

#### **四、晶圆代工厂**

1、国际：格罗方德、三星（中国）半导体有限公司、Tower Jazz、Dongbu、美格纳、IBM、富士通、英特尔、SK海力士半导体（中国）有限公司

2、中国大陆及台湾：台积电、联电、和舰科技、力晶、中芯国际、华虹宏力、德茂、武汉新芯、华微电子、华力微电子、力芯、英特尔半导体（大连）有限公司、西安微电子、吉林华微电子

#### **五、封装与测试企业**

1、国际：安靠、星科金朋、J - devices、Unisem、Nepes

2、中国大陆及台湾：日月光、力成、南茂、颀邦、京元电子、福懋、菱生精密、矽品、长电、优特、先进半导体、通富微电、天水华天、南通华达微电子、威讯联合半导体、英特尔产品（成都）有限公司、海太半导体（无锡）有限公司、江苏新潮科技、安靠封装测试（上海）有限公司、晟碟半导体（上海）有限公司、力成

#### **六、IDM**

1、国际：英特尔、三星、飞思卡尔、海力士、NEC、NXP、Renesas、意法半导体、TI、东芝

2、大陆：上海贝岭、华润微电子、士兰微电子

#### **七、电子元器件分销商**

1、国际：安富利、艾睿、富昌电子、WPG、TTI、Macnica、Digi - Key Corporation、Newark Element14、Mouser Electronics、Fusion Worldwide

2、中国：科通、中电、路必康、泰科源、维时信、帕太、信和达、芯智、北高智、亚讯

#### **八、电子制造业服务商（EMS）**

1、国际：伟创力、捷普、天弘、新美亚、佰电、贝莱胜、创业制造、科泰、希克斯、卓能

2、中国：鸿海、新金宝、长城开发、环旭、华泰、华硕、广达、英业达、冠捷、纬创资通

## 九、终端品牌商

1、国际：苹果、三星、IBM、索尼、东芝、戴尔、富士通、NEC、松下、惠普

2、中国：华为、中兴、lenovo、小米、OPPO、华硕、宏基、神州、魅族、酷派

## 十、EDA设计软件厂商

1、国际：Synopsys、Mentor、Cadence

2、中国：华大九天、芯禾科技、广立微、博达微、芯愿景、爱克赛利、圣景微、技业思、讯美等

## 十一、IGBT供应链

IGBT是半导体分立器件重要的组成部分，目前全球有70%IGBT模块市场被日系企业控制，德系的英飞凌在独立式IGBT功率晶体领域拥有24.7%的全球最高市占率。中国本土的IGBT厂商目前做得最出色的是中车时代、嘉兴斯达以及比亚迪等。

国外：日立、英飞凌、三菱、富士电机、东芝、ABB、安森美、ADI、Vishay、赛米控、威科、丹佛斯、艾赛斯等。

国内：IDM厂商主要有中车时代、嘉兴斯达、比亚迪、士兰微、华微、中航微电子、中环股份等；模块/设计厂商主要有永电、爱帕克、新佳、宏微、南京银茂等；设计厂商有中科君芯、芯派、华微斯帕克、达斯、同方微、新洁能、金芯微电子、科达等；在制造方面，主要厂商有华虹宏力、先进半导体、中芯国际、方正微、华润上华等。

## 十二、MLCC供应链

目前，全球MLCC（片式多层陶瓷电容器）主要由日韩厂商主导，其中日本村田（Murata）是全球最大的MLCC供应商。韩国三星电机全球MLCC市占率仅次于村田。

国外：日系的有村田、太阳诱电、京瓷、TDK等，韩系的主要有三星电机、三和电容等。

国内：台厂国巨、华新科、禾伸堂，陆厂风华高科、宇阳科技、火炬电子等。

## 十三、液晶屏面板供应链

**芯片厂商：**矽创、联咏、奇景、格科微、旭耀、天利、天域、瑞鼎、瑞萨、新向微、奕力等。

**模组厂商：**天马、同兴达、信利、三龙显示、TCL显示、帝晶、中光电、天亿富、比亚迪、永信、星源、煜彩、国显、京东方、宝锐视、亿都、夏普、东芝、NEC、日立、京瓷、三菱、索尼、富士通、亿华、博

一、雅视、易欣达、优纳思、维拓、比亚迪、宇顺、海飞、德思普、凯圣德、立德通讯、莱宝、兴展、聚睿鼎、易快来等等。

**面板制造厂商：**韩国有LG，三星，HYDIS，现代，金星等；欧美有元太、IBM，Pixel Qi，爱普生，FINLUX等；日本则有夏普（被鸿海收购），东芝、松下、NEC、京瓷、三菱、光王、鸟取三洋、索尼、IDTech、富士通、精工、IPS Alpha、卡西欧、STI、先锋、星电、IMLS、西铁城、阿尔卑斯等。

**大陆面板厂：**近年迅速崛起，以京东方为首的面板商已成功打入苹果供应链。除京东方之外，国内主要厂商还有天马、奇信、龙腾、上广电、奇菱、凌巨、清达光电、信利、中星光电、中电熊猫、比亚迪、华森、海信、维信诺、翰图微、长智光电、彩虹、宝锐视、德邦、虹欧、吉林彩晶、亿都、平达、静电、智炫等。

**中国台湾面板制造商：**主要有奇美 - 群创、友达、中华映管、瀚宇彩晶、统宝、锦祥、广辉、ORTUSTECH、全台晶象、联友、奇晶、达基、晶采、晶达、众福、久正光电、光联、悠景、台盛、富相、智晶、铌宝科技、南亚光电等。

**触控芯片厂家：**艾特梅尔（Atmel）、比亚迪微电子、赛普拉斯（Cypress）、敦泰、晨星（Mstar）、汇顶科技、新思国际（Synaptics）、思立微、君曜、迅骏、集创北方、矽创、贝特莱、联咏、奇景、奕力、美法思、致达科创、晶门、海尔、胜力等。十四、手机触控产业链

**触控屏厂家：**3M、LG Innotek、富士通（Fujitsu）、Nissha、夏普（Sharp）、欧菲光、信利、伯恩光学、中华意力、宸鸿（TPK）、深越光电、合力泰、业际、超声、莱宝、洋华、联创、胜大、骏达、帝晶、德普特、俊达、容纳、宇顺、华睿川、旭顶、华兴达、天翌、欧雷登、航泰、婉晶、智恒卓越、平波、兴展、中海、帝仁、帝显、秋田微、德怡、普达、敦正、威广骏、裕成、彩通达、宝明、盛诺、京东方、正星、鸿展光、南玻、普星、比欧特、世同、煜焯、北泰显示等。

## 十五、连接器供应链

国外连接器巨头：泰科电子、莫仕、安费诺、FCI、申泰、Jae、3M、矢崎、JST、菲尼克斯、德尔福、KET、松下电工、广濑电机、住友电气、魏德米勒、哈丁、然湖电子、欧度等。

中国连接器巨头：立讯精密、中航光电、长盈精密、得润电子、日海通讯、航天电器、吴通控股、永贵电器、瑞宝股份、四川华丰、航天电子、富士康、实盈股份、连展科技、禾昌、正崧等。

## 十六、LED芯片供应链

近年，大陆LED厂商迅速崛起，助推中国成为全球最大的LED芯片制造国。目前，全球LED芯片市场主要分为三大阵营：日本、欧美厂商为第一阵营，韩国、台湾为第二阵营，大陆厂商为第三阵营。

## 十七、国外LED芯片厂商

日亚化学（日本）、丰田合成（日本）、科锐（美国）、欧司朗（德国）、安捷伦（美国）、东芝（日本）、流明（总部在美国，被飞利浦收购）、首尔半导体（韩国）、昭和电工（日本）、旭明（美国）等。

国内LED芯片 / 封装厂商：大陆公司主要有三安光电、同方光电、华灿光电、乾照光电、德豪润达、澳洋顺昌、士兰明芯、圆融光电、蓝光科技、雷曼光电、蓝宝石光、福日电子、晶蓝光电、湘能华磊、聚灿光电、晶能光电、晶科电子、方大集团、晶宇光电、华联电子、升谱光电等。

台湾：主要有晶元光电、华上光电、合晶光电、璨圆光电、泰谷光电等。

## 十八、国内传感器供应链

上市公司：歌尔声学、航天电子、华天科技、东风科技、航天机电、通鼎互联、华工科技、科陆电子、士兰微、机器人、紫光国芯、苏州固锝、汉威电子、中航电测、三诺生物、新联电子、上海贝岭、晶方科技、威尔泰等。

在华外资：西门子传感器与通讯（SSCL）、西克传感器（广西）、图尔克（天津）传感器、美捷特（厦门）、MTS传感器中国、巴鲁夫传感器（成都）、威格勒传感器（上海）、德尔达传感器（常州）、墨迪传感器（天津）等。

## 十九、电池产业链

正极材料厂家：日亚化学、户田工业、清美化学、田中化学、三菱化学、L&F、UMICORE、Ecopro、A123、Valance、Saft、湖南杉杉、北大先行、当升科技、巴莫科技、湖南瑞翔、宁波金和、天骄科技、厦门钨业、振华新材、乾运高科等。

负极材料厂家：日本化成、日本碳素、JFE 化学、三菱化学、贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸、深圳斯诺、星源石墨、江西正拓、湖州创亚、天津锦美、成都兴能等。

隔膜厂家：旭化成、Celgard、Exxon—Tonen、日本宇部、住友化学、SK、星源材质、中科科技、金辉高科、沧州明珠、河南义腾、南通天丰、东航光电、河北金力、天津东皋、山东正华等。

电解液厂家：新宙帮、多氟多、三菱化学、富士药品工业、三井化学、森田化学、关东电化、

SUTERAKEMIFA、韩国三星、江苏国泰、天津金牛、东莞杉杉、广州天赐、东莞凯欣、珠海赛纬电子、北

京化学试剂研究院、汕头金光、潮州创亚等。

## 二十、半导体分立器件厂商

目前，全球半导体分立器件主要欧美日欧等国家地区垄断，尤其在高端市场拥有绝对的话语权。由于国内厂商尚未形成规模效应与集群效应，所以其生产仍以“代工”模式为主。

美国：美国半导体分立器件目前居于全球领先地位，拥有一大批如TI、IR（国际整流器）、Diodes、Fairchild（被ON收购）、ON（安森美）、Vishay等在全球拥有绝对影响力的分立器件制造商。除此之外，美国半导体厂商在电源管理芯片领域也拥有绝对优势，其市场客户主要针对亚太市场。

欧洲：主要有Infineon（英飞凌）、NXP（被美国高通收购）、ST（意法半导体）等全球知名半导体厂商，产品线齐全，无论是IC还是分立器件都具有领先实力。从市场客户分布来看，亚太地区也是欧洲厂商最大的应用市场，其次是欧洲市场。

日本：日本也是全球半导体分立器件厂商主力国，主要有东芝（Toshiba）、瑞萨（Renesas）、罗姆（Rohm）、富士电机（Matsushita Fuji）等半导体厂商。日本厂商在半导体分立器件方面具有较强竞争力且厂家众多，但很多厂商的核心业务并非半导体分立器件，从整体市场份额来看，日本厂商落后于美国厂商。从日本厂商的市场客户分布来看，日本国内是其最大的市场，其次是亚太（不包括日本）市场，在欧美市场占有少量的市场份额。

中国台湾：台湾的半导体分立器件芯片及成品市场近年发展较快，拥有立铸（NichTek）、富鼎先进（A - Power）、茂达（Anpec）、崇贸（SG）等厂商。产品方面，除了崇贸（SG）提供AC / DC产品之外，台湾地区厂商主要偏重于DC / DC领域，主要产品包括线性稳压器和功率MOSFET等。总体来看，台湾地区半导体分立器件厂商的发展较快，技术方面和国际领先厂商间的差距进一步缩小，产品主要应用于计算机主板、显卡和LCD等设备。

中国大陆：近年，中国半导体分立器件的全球话语权正在稳步提升，目前已是全球最大的分立器件市场。香港、台湾、韩国为国产半导体分立器件主要出口市场，其中，香港为最大出口市场。目前，广东、江苏、上海稳居国内半导体分立器件出口量前三名，国内半导体分立器件出口大省仍以沿海各省为主。

本土分立器件厂商主要有扬杰科技、华微电子、苏州固执锔、台基股份、凯虹科技、华联电子、乐山无线电、华汕电子、勤益电子、希尔电子、卫光科技、辽晶电子、明昕微电子、燕东微电子、银河世纪微电子、深爱半导体、爱尔半导体、亚光电子、华润微电子、中环半导体、东晨电子等。

## 二十一、手机摄像头产业链

芯片厂家：格科微、OV、思比科、索尼、三星、海力士、奇景、海力士、Aptina等。

镜头厂家：旭业光电、川和田光电、深圳大立、理念光电、舜宇光学、都乐光电、新旭、精龙达、华鑫光电、兴邦光电等等。

模组厂家：舜宇、欧菲光，信利，丘钛微、盛泰、成像通、美细奈斯、光阵、金康、凯木金、方德亚、日永、桑莱士、三赢兴、东恒盛、统聚、博立信、大凌、科特通、卓锐通、鑫晨光、四季春、光宝、群光、富士康、亿威利、东聚、中光电、正桥影像、百辰、凯尔、敏像、康隆等等。

摄像头马达厂家：阿尔卑斯（ALPS）、三美电机（Mitsumi）、TDK、Jahwa（磁化）、SEMCO（三星电机）、新思考（Shicoh）、比路、Hysonic、LG - Innotek（LG - 伊诺特）、索尼、松下、Partron、Optis、富士康、美拓斯、贵鑫磁电、金诚泰、新鸿洲、中蓝、瑞声科技、皓泽电子、友华微、磊源、艾斯、精毅电子、良有电子等。

## 二十二、元器件分销商

国外：安富利（美国）、艾睿（美国）、贸泽（美国）、得捷（美国）、艾买克（美国）、TTI、赫联电子（美国）、富昌电子（加拿大）、威雅利（新加坡）、新晔（新加坡）、欧时电子（英国）、世健（新加坡）、Premier Farnell（英国）、儒卓力（英国）、导科国际（日本）等。

中国大陆：科通集团、中电器材、深圳华强、好上好控股、新蕾电子、商络电子、泰科源、世强、贝能国际、路必康、维时信、利尔达、润欣科技、亚讯科技、力源信息、英唐智控、韦尔半导体、丰宝电子、梦想电子、天涯泰盟、芯智科技、淇诺电子、卓越飞讯、驰创电子、鼎芯无限、信和达、周立功、捷扬讯科、雷度电子、元六鸿远、基创卓越、晶川电子等。

中国台湾：大联大、百微股份、益登、弘忆国际、禾伸堂、三顾电子、普途电子、倍微科技、彦阳科技、圣邦科技、希马科技、佳营电子、联强国际、威健、文晔、丰艺电子、增你强等。

中国香港：帕太集团、骏龙科技、创达电子、首科电子、创兴电子、三全科技、鹏华电子、百特集团、赫连德亚太区（香港）有限公司、至高电子、金丰捷电子、蓝柏科、扬帆科技、创意电子、时捷集团、威柏电子、棋港电子、易达电子等。

<https://www.21ic.com/article/903886.html>